Pressemitteilung

**Modernes Design, einteiliger Aufbau, reduzierter Montageaufwand**

**tde stellt Redesign des tML-Modulträgers für den Festeinbau vor**

**Dortmund, 21. September 2021. Der Dortmunder Netzwerkspezialist tde – trans data elektronik hat seinen 19-Zoll tML-Modulträger für den Festeinbau grundlegend überarbeitet: Das neue Modell präsentiert sich nicht nur im modernen Design, sondern bringt auch eine verbesserte Funktionalität mit. Der tML-Modulträger hat eine Aufnahmekapazität von bis zu acht Modulen der Produktreihen tML-Standard, tML-Xtended, tML-24 und tML-32. Bei voller Bestückung bietet er auf einer 19-Zoll-Höheneinheit Platz für 96 x LWL-LC-Duplex Ports mit 192 Fasern, 96 x 12-Faser-MPOs mit 1152 Fasern oder 96 x 24-Faser-MPOs mit 2304 Fasern. In Verbindung mit dem LWL-MDC-Modul erreicht der Modulträger eine Verdoppelung der Packungsdichte gegenüber LC-Duplex und bietet in Kombination mit dem innovativen tML-24 die branchenweit höchste Packungsdichte und größte Flexibilität bei der Migration zu hohen Übertragungsraten.**

Das Design hat der Netzwerkspezialist an den seit 2017 am Markt erfolgreichen ausziehbaren Modulträger angeglichen. Damit wirkt der Träger, bei dem die Befestigung der Module über Schrauben in der Frontplatte erfolgt, im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich moderner. Der stabile Träger besitzt ein einteiliges Design. „Zusätzliche Teile, wie etwa Einführungen für Breakoutkabel, sind nicht notwendig – diese sind bereits rückseitig über die gesamte Breite integriert“, erläutert André Engel, Geschäftsführer der tde. „Das spart Netzwerktechnikern bei der Montage vor Ort Zeit.“

Um die wertvollen Installationszeiten weiter zu reduzieren, kann auch die vom ausziehbaren Modulträger bekannte, formschöne Abdeckung mit integrierter Patchkabelführung zum Einsatz kommen. Sie verbessert die horizontale Patchkabelführung und stellt einen Zugriffsschutz für die Ports dar. Netzwerktechniker erhalten damit zugleich die Option, den magnetischen Beschriftungsstreifen zu beschriften und die Verkabelung sauber zu dokumentieren. Kunden profitieren mit dem neuen tML-Modulträger für den Festeinbau von verbesserter Funktionalität bei gleichzeitiger Preisstabilität: Der neue Modulträger ist nicht teurer als die Vorgängerversion.

*Höchste Packungsdichte*

Wie der ausziehbare Modulträger punktet auch der neue tML-Modulträger für den Festeinbau in Verbindung mit den tML-Systemplattformen mit maximalen Packungsdichten und größter Flexibilität bei der Migration zu hohen Übertragungsraten von derzeit 400 G: Bei voller Bestückung mit acht Modulen kann der neue 19-Zoll tML-Modulträger bis zu 96 x LWL-LC-Duplex Ports mit 192 Fasern, 96 x 12-Faser-MPOs mit 1152 Fasern oder 96 x 24-Faser-MPOs mit 2304 Fasern aufnehmen. Auch Belegungen mit 16-Faser-MPOs, 32-Faser-MPOs sind möglich. Innerhalb eines Modulträgers lassen sich unterschiedliche Module mit LWL- und Kupfer-Ports, beispielsweise RJ45, kombinieren. Mit dem 2020 eingeführten und branchenweit ersten LWL-MDC-Modul für die tML-Plattform erzielen Unternehmen, Planer und Netzwerktechniker eine Verdoppelung der Packungsdichte im Patchbereich im Vergleich zu LC-Duplex-Steckverbindern: Dafür hat die tde als erster Hersteller den kompakten MDC-Steckverbinder von US Conec in ihr tML-Verkabelungssystem integriert. Gleichwohl sind auch ältere Anschlusstechnologien wie SC, ST oder E2000 mit dem tML kompatibel.

*Das tML – tde Modular Link-System*Das patentierte modular aufgebaute Verkabelungssystem tML besteht aus den drei Kernkomponenten Modul, Trunkkabel und Modulträger. Die Systemkomponenten sind zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt, vorkonfektioniert und getestet. Vor Ort – insbesondere in Rechenzentren, aber auch in industriellen Umgebungen – ermöglichen sie die Plug-und-play-Installation innerhalb kürzester Zeit. Herz des Systems sind die rückseitigen MPO-/MTP- und Telco-Steckverbinder, über die sich mindestens sechs beziehungsweise zwölf Ports auf einmal verbinden lassen. Je nach Modulbestückung sind derzeit Übertragungsraten von bis zu 400 G möglich. Die LWL- und TP-Module lassen sich zusammen in einem Modulträger mit sehr hoher Portdichte gemischt einsetzen.

**Über die tde – trans data elektronik GmbH**  
Als international erfolgreiches Unternehmen ist die tde – trans data elektronik GmbH seit 30 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung skalierbarer Verkabelungssysteme für größte Packungsdichten spezialisiert. Auch das Kernforschungszentrum CERN vertraut auf das Know-how des Technologieführers in der Mehrfasertechnik (MPO).   
Das Portfolio „Made in Germany“ umfasst komplette Systemlösungen mit Schwerpunkt Plug-and-play für High-Speed-Anwendungen im Bereich Datacom, Telecom, Industry, Medical und Defence. tde bietet mit einer eigenen Service-Abteilung Planungs- und Installationsleistungen aus einer Hand und unterstützt den „European Code of Conduct“ für Energieeffizienz in Rechenzentren. Mehr unter: [www.tde.de](http://www.tde.de/) sowie auf [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/tde-trans-data-elektronik-gmbh/), [Twitter](https://twitter.com/tdeConnect) und [Xing](https://www.xing.com/companies/tde-transdataelektronikgmbh/updates).   
  
**Unternehmenskontakt**tde – trans data elektronik GmbH, Vertriebsbüro Dortmund  
André Engel, Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46, D - 44135 Dortmund  
Tel. +49 231 160480, Fax +49 231 160933, [info@tde.de](mailto:info@tde.de), [www.tde.de](http://www.tde.de/)

**Pressekontakt**epr – elsaesser public relations, Maximilianstraße 50, D - 86150 Augsburg

Frauke Schütz, Tel: +49 821 4508 7916, [fs@epr-online.de](mailto:fs@epr-online.de)

Elke Thiergärtner, Tel: +49 821 4508 7912,et@epr-online.de

[www.epr-online.de](http://www.epr-online.de)